

工研院綠能所採購規範書

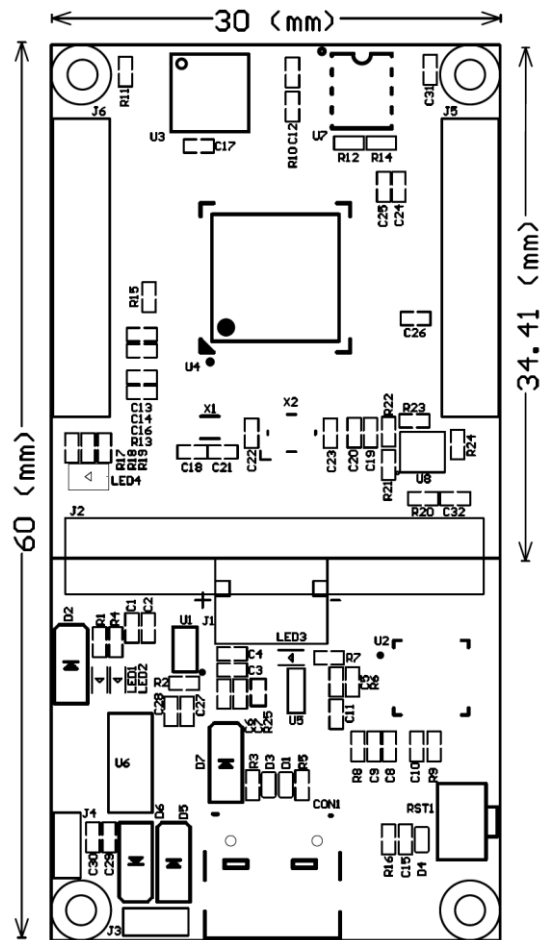
購案名稱：堆疊式運算單元硬體外殼設計製作

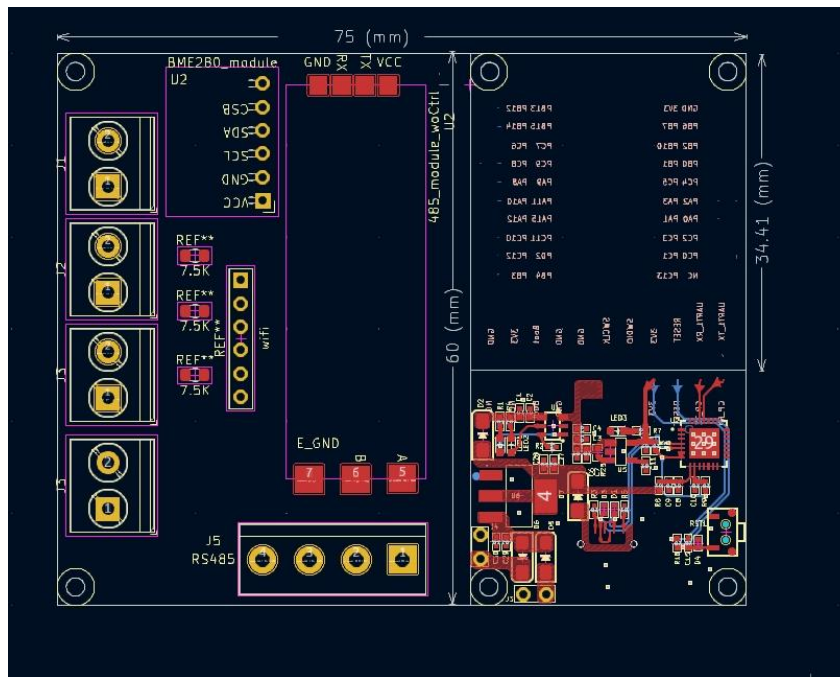
一、 工作項目：

1. 依工研院提供堆疊式運算單元硬體之電路板尺寸設計外殼
2. 三層式電路板堆疊結構固定設計
3. 鋁金屬與塑膠複合式外殼
4. 內部無線訊號優化機構設計
5. 外殼標示雷雕
6. 提供 3 組設計圖
7. 50 組成品製作
8. 提供 50 組 NB-IoT 匹配天線
9. 廠商需具備智慧電表通訊模組相關產品外殼開發經驗，並配合天線訊號驗證測試

二、 主要規格：

■ 電路板圖例





- 區域電網智慧節點技術開發之電路板為三層堆疊，各層詳細資料，廠商將於得標後取得

三、 結案驗收：

結案驗收時按上述規格辦理，交付成果之內容經請購單位確認，各項規格合於需求者方可完成驗收。